



Umfassende Lösungen, die den gesamten Prozess von der Beschaffung bis zur Qualitätssicherung abdecken.

Unsere Fertigungstechnologien



Leiterplatten-Bestückung

Die Leiterplatten-Bestückung ist Kernprozess in unserer Fertigung. Mit hochwertigster Technik, qualifiziertem Personal und effizienten Technologien gewährleisten wir Spitzenqualität. Aktuell liegt unsere Kapazität von bis zu 320.000 Bauteilen pro Schicht bei Losgrößen bis zu 100.000 Stück.



Automatisches und manuelles Lötén

Wir sind hervorragend auf die Fertigung komplexer Baugruppen vorbereitet. Unsere hochmoderne Ausrüstung gewährleisten eine erstklassige Lötqualität, während unser erfahrenes Personal das Unmögliche realisiert.



Passivieren ■ Lack ■ Verguss

In anspruchsvollen Umgebungen, wie der Luftfahrttechnik, verlängern Teil- oder Volllackierungen sowie Verguss die Produktlebensdauer. Wir bieten maßgeschneiderte Technologien, um Baugruppen unter harten Bedingungen zu schützen und die Zuverlässigkeit zu erhöhen.



+49 351 318500



www.dresden-elektronik.de



Enno-Heidebroek-Straße 12
Dresden

Prozess	Einzelschritte	Prototypen	Losgrößen < 1000 Stück	Losgrößen > 1000 Stück
Materialwirtschaft	Eigener Materialeinkauf	x	x	x
	Beistellungen vom Kunden	x	x	
	BE-Substitution / Reliability		x	x
	Sonderteile		x	x
	Bevorratung mit kritischen Bauelementen		x	x
BE-Lagerung	Trocknen von Bauelementen (MSL)	x	x	x
	Trockenschrank	x	x	x
	Vakuum-Verpackung	x	x	
	Gurtservice		in Koop.	in Koop.
	Profilieren und Schneiden	x	x	x
SMD-Bestückung von LP	Lotpasten-Siebdruck (verbleit / bleifrei)	x	x	x
	Drucken / Dispensen von SMD-Kleber	x	x	x
	Automatenbestückung	x	x	x
	Seriennummern / Traceability	x	x	x
	Reflowlöten (verbleit / bleifrei) unter Stickstoffatmosphäre	x	x	x
	Musterbestückung	x		
THT-Bestückung	Handbestückung	x	x	x
	Selektivlöten (verbleit / bleifrei) unter Stickstoffatmosphäre		x	x
	Wellenlöten (verbleit / bleifrei) unter Stickstoffatmosphäre	x	x	x
	Einpressen	x	x	
Stückprüfung	AOI		x	x
	Funktionsprüfung, EMV-Prüfung	x	x	x
	Elektrische Sicherheitsprüfungen	x	x	x
	Boundary Scan		x	x
	Burn-In	x	x	x
	Flying-Probe	x	x	
LP-Vereinzeln	Nutzentrenner mit Rollenmesser	x	x	x
	Stegtrenner	x	x	
BG-Wäsche/Passivierung	Ultraschall-/ Sprühereinigung	x	x	x
	Spritzlackieren / Tauchlackieren	x	x	
	Selektivlackieren	x	x	x
	2K-Verguss	x	x	x
Inspektion / Reparatur	BGA-Reparatur	x		
	Röntgen / Ultraschallinspektion	in Koop.	in Koop.	in Koop.
	Kamerainspektion	x	x	
Kabelkonfektionierung	Ablängen / Abisolieren / Crimpen / Pressen	x	x	x
	Kabelprüfung	x	x	x
Mechanische Bearbeitung	Gravieren	x	x	
	Siebdruck / Laserbeschriftung	in Koop.	in Koop.	in Koop.
	3D-CNC-Fräsen mit bis zu 5 Achsen	x	x	x
	Drehen / Bohren / Gewindeschneiden / Sägen	x	x	in Koop.
	Blechteilbearbeitung	x	in Koop.	in Koop.
	Spritzguss von Kunststoffteilen	in Koop.	in Koop.	in Koop.
Gerätebau	Montage / Justage elektronischer Geräte	x	x	x
Qualitätssicherung	Erstmusterprüfbericht	x	x	x
	Abnahmeprüfzeugnis	x	x	x
	8D-Report	x	x	x